

北京君正集成电路股份有限公司 关于重大投资框架协议到期终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 12 月 30 日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）披露了《关于签署重大投资框架协议的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（公告编号 2016-111）。根据协议约定，该协议于 2017 年 3 月 30 日到期，公司决定协议到期后不再协商延长有效期或签署正式购买协议。现将具体情况公告如下：

一、投资框架协议的基本情况

2016 年 12 月 30 日，鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）100%股权、北京视信源科技发展有限公司 100%股权及北京思比科微电子技术股份有限公司 40.4343%股权（以下简称“重大资产重组”），为使并购完成后北京豪威有一个长期稳定的经营场所，公司拟购买由北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司（以下简称“集成电路设计园”）开发建设的办公楼。经北京君正、北京豪威和集成电路设计园友好协商，就购买事宜三方签订了《框架协议》。

根据协议约定，公司应于 2016 年 12 月 30 日上午 12 时前缴纳人民币 5,000,000 元作为认购定金，该定金将在签署正式买卖合同时转为购房款，如双方无法协商一致，公司放弃购买集成电路设计园办公楼事宜，集成电路设计园将在公司提交申请后 7 个工作日内，将此认购定金全额无息退还公司。

协议有效期为：自协议生效之日起至 2017 年 3 月 30 日止。三方应在有效期截止前签署正式购买协议。三方如一致同意延长有效期，需在协议有效期到期前签署书面补充协议。

二、终止原因

由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产重组的交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。鉴于此，本框架协议到期后，公司决定放弃购买集成电路设计园办公楼事宜，不再协商延长有效期或签署正式购买协议。

三、对公司的影响

投资框架协议到期终止后，不再协商延长有效期或签署正式购买协议，是基于公司重大资产重组事项的客观情况作出的决策，符合公司实际情况，不会对公司经营带来重大不利影响。根据协议约定，亦不存在违约风险。同时，集成电路设计园将全额无息退还公司缴纳的人民币 5,000,000 元认购定金。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日